

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，故此並無載有可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下在決定投資**[編纂]**前應閱讀整份文件。

任何投資均涉及風險。部分有關投資**[編纂]**的特定風險載於本文件「風險因素」。閣下在決定投資**[編纂]**前應細閱該節。

我們是誰

我們秉持「材料+構築美好生活」的願景。

我們以深厚的「材料」基因為根基，確立「材料+結構+功能」的戰略發展方向，深耕先進電子陶瓷材料和零部件領域超55年。根據弗若斯特沙利文的資料，始終聚焦先進陶瓷材料主業的我們，現已成長為先進電子陶瓷材料和零部件領域的全球領先企業。我們構建起電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件、設備組件等四大類核心產品矩陣，形成覆蓋通信、AI及數據中心、消費電子、汽車電子、半導體製造及封裝、新能源、智能工業控制等核心應用領域，囊括基礎材料、關鍵元件和高端器件及組件的業務框架。

根據弗若斯特沙利文的資料，憑藉深厚的技術沉澱與規模化優勢，我們多款核心產品全球市佔率穩居前列，體現了強大的全球競爭力。在關鍵領域，核心技術已逐步突破，為實現國產替代及供應鏈自主可控提供關鍵支撐。

立足於「材料+工藝」一體化業務模式，我們實現了卓越的盈利能力。具體而言，我們實現端到端自主與管控，覆蓋上游關鍵原材料配方的研發和關鍵製造工藝的迭代優化。除盈利能力外，此一體化模式進一步強化了我們抵禦外部供應鏈風險的韌性。同時，我們具備大批量生產能力，實現高標準品控，築牢規模化運營、質量穩定與成本可控的核心優勢。

概 要

我們維持穩固的業界領先品牌地位，與主要終端市場的關鍵客戶建立了長期緊密的合作關係。依託技術、服務及產業鏈三維協同模式，我們將本土化服務與全球標準結合，不斷加強客戶黏性，提升客戶全生命週期價值。

我們憑藉「國內多基地+海外多支點」的生產網絡與覆蓋全球核心市場的銷售體系，實現全球產能動態精準調配，推動海外營收持續增長；同時通過多源採購與供應協同，強化抵禦外部干擾的抗風險韌性。

我們搭建「研究院+事業部」雙核研發架構，從陶瓷粉體等材料本源出發，貫穿成型、燒結等關鍵工藝。通過持續專利積累與行業標準參與，我們將材料突破高效轉化為可量產的產品平台，形成「技術研發—產品落地—市場驗證」的商業化閉環，為全球市場競爭力提供強大技術支撐。

我們的業務覆蓋七大核心應用，具備較好的行業增長動能。通過優勢旗艦產品與高增長潛力戰略產品高效協同，我們不斷夯實收入基本盤，同時充分利用行業有利形勢。

深耕行業的穩定管理層團隊與「制度—機制—文化」三維治理，為我們持續深耕先進電子陶瓷材料主業、鞏固全球領先地位提供堅實支撐。

概 要

我們已在先進電子陶瓷材料和零部件領域取得了全球矚目的成就：



註：

- (1) 根據弗若斯特沙利文數據；
- (2) 氧化鋁陶瓷基板，陶瓷插芯及套筒及SOFC隔膜片，按2024年收入計；
- (3) 自我們的A股於2014年12月在深圳證券交易所創業板上市以來；
- (4) 在往績記錄期間；
- (5) 往績記錄期間內，公司與前五大客戶的業務合作年限平均值(按各年度/期間分別計算，計算依據為與該等客戶的合作年限)；
- (6) 截至2025年9月30日。

我們的業務板塊

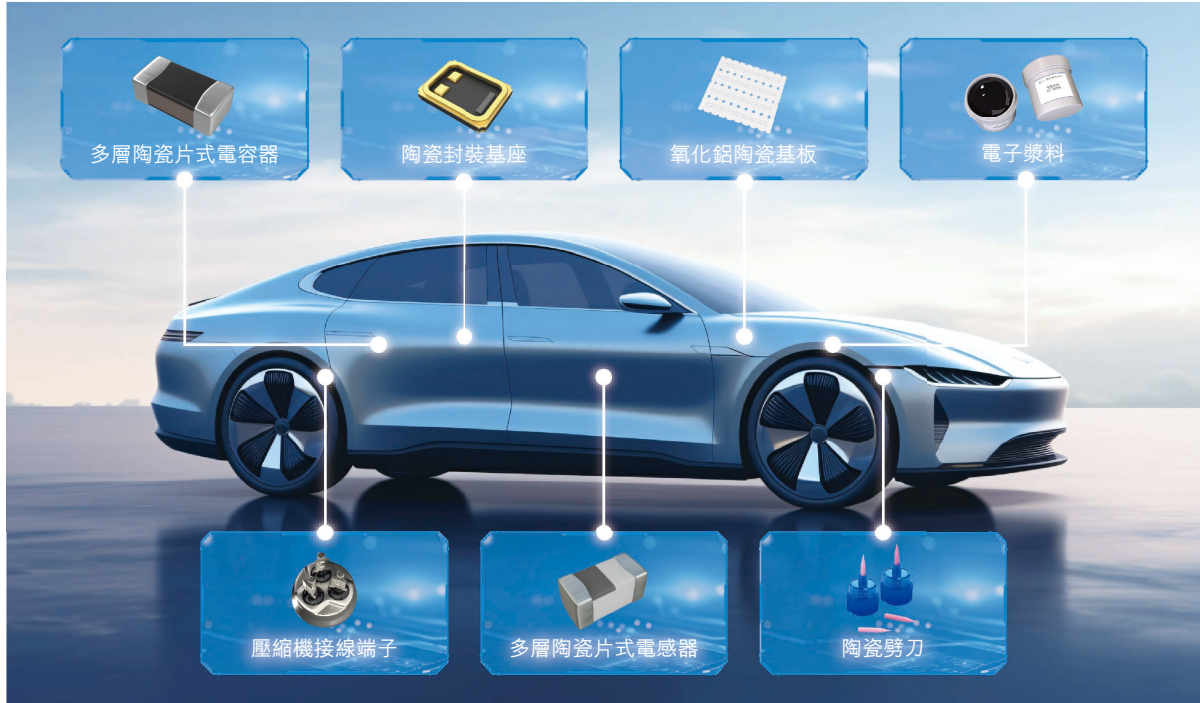
我們提供多元化的產品組合，包括(i)電子及陶瓷材料、(ii)電子元件、(iii)通信器件及(iv)設備組件四大主要類別。

概 要



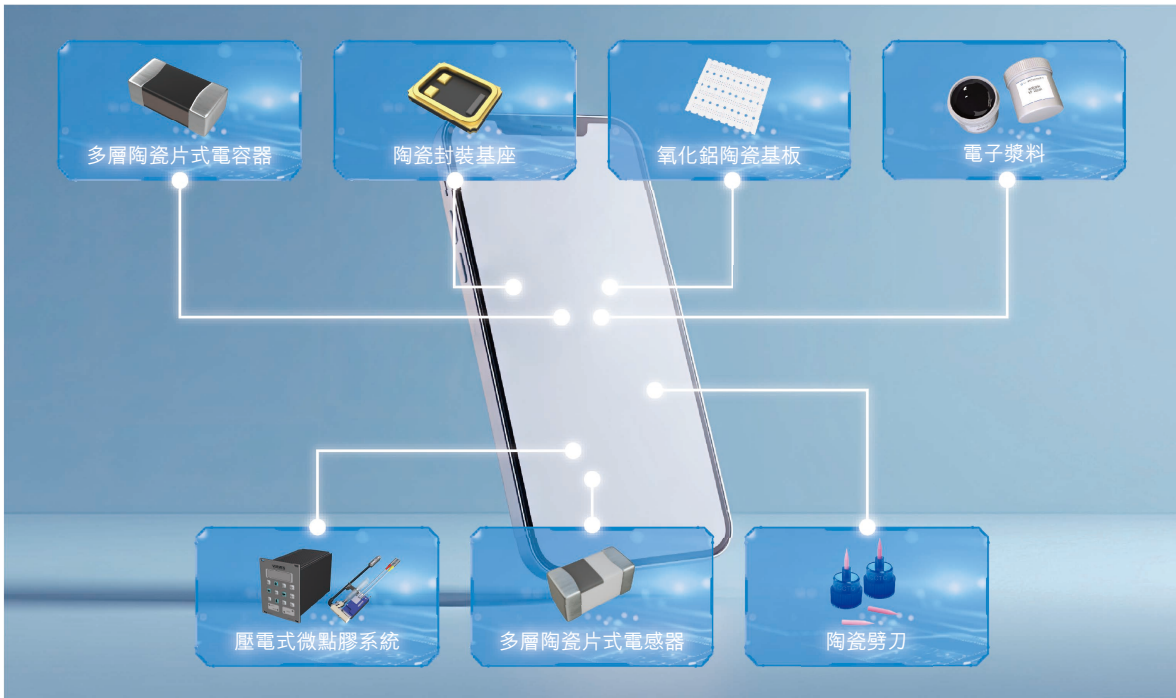
我們的產品應用於各類終端設備及基礎設施，包括汽車、手機、數據中心、基站等。

汽車



概 要

手機



數據中心



概 要

基站



電子及陶瓷材料

我們聚焦於電子產業鏈的上游基礎材料，主要包括氧化鋁陶瓷基板、氮化鋁陶瓷基板、電子漿料及固體氧化物燃料電池（「**SOFC**」）隔膜片等。

電子及陶瓷材料作為上游核心材料，應用於消費電子、汽車電子、新能源等領域，共同支持電子元件製造及新能源燃料電池應用，其中：

- 氧化鋁陶瓷基板作為基礎材料，為消費電子中的片式電阻器提供電氣絕緣、散熱與機械支撐；
- 電子漿料系列包括電阻、掩膜、導體及二次樹脂漿料，用於精密電子元件等的電極印刷；及

概 要

- **SOFC**隔膜片，起到傳導氧離子並分隔燃料與氧化劑的作用，並在高溫環境下推動化學能直接轉化為電能的電化學反應，是固體氧化物燃料電池核心部件之一。

根據弗若斯特沙利文的資料，我們的產品已在部分細分領域形成顯著競爭力，例如：氧化鋁陶瓷基板歷經多次技術升級和擴產，逐漸實現了片式電阻器全規格覆蓋。我們現已發展為全球氧化鋁陶瓷基板的頭部供應商之一，按**2024**年的收入計，全球市佔率超**50%**。電阻漿料推動了厚膜電阻器的供應鏈國產化進程。根據弗若斯特沙利文的資料，**SOFC**隔膜片為推動能源轉型的**SOFC**系統的關鍵元件之一，按**2024**年的收入計，我們的**SOFC**隔膜片全球市場份額排名第一。

電子元件

我們的電子元件產品矩陣包括多層陶瓷片式電容器（「**MLCC**」）、多層陶瓷片式電感器（「**MLCI**」）及固定電阻器。電容器、電感器及電阻器為電路中應用廣泛的三大基礎被動元件。**MLCC**已成為該類別收入增長的主要驅動力。憑藉我們多年來累積的技術能力及我們的持續研發投入，我們拓展了產品線與規模化供應，以滿足多元化應用場景。同時，我們協同供應**MLCC**、**MLCI**及電阻器，滿足客戶一站式採購服務需求，提升多品類元件的適配性。

根據弗若斯特沙利文的資料，技術迭代和應用升級推動了該等元件的需求增長，尤其是在**AI**及數據中心、汽車電子等領域表現突出，催生了對高端化被動元件的新增需求。

我們聚焦於技術、交付、客戶觸達及產能：

- **技術**。高端**MLCC**實現介質層膜厚約**1**微米，堆疊層數達**1,000**層以上，為切入高端應用場景奠定基礎。
- **交付**。我們依託全流程高度自動化生產，可保障大額訂單的高質量交付。

概 要

- **客戶**。我們已獲得下游各大核心場景關鍵客戶的認證。
- **產能**。我們的產能隨訂單增長同步擴張，已實現大規模量產。

我們認為，上述幾個方面使我們從行業增長和市場份額提升中獲益。

通信器件

我們聚焦於光通信部件與半導體配套封裝核心需求，形成覆蓋光通信連接、封裝部件和晶振封裝的多元化產品矩陣。我們的通信器件產品組合包括陶瓷插芯及套筒、陶瓷封裝基座、機械轉接（「**MT**」）插芯及短纖及光通信陶瓷封裝管殼。這些產品對應通信產業鏈不同關鍵環節，共同構成我們在通信、**AI**及數據中心、半導體製造及封裝領域的綜合供給能力。

我們的通信器件產品是我們鞏固光通信領域優勢地位、拓展半導體製造及封裝賽道的核心抓手。

- 陶瓷插芯及套筒以高精密對準性能，降低高速寬帶接入的信號損耗，實現光纖的精準對接，深度適配光纖入戶（「**FTTH**」）、**5G**基站、數據中心三大場景。
- 針對**AI**及數據中心爆發式增長帶來的高密度、高帶寬連接訴求，**MT**插芯及短纖提供低延遲、高可靠的光通信解決方案，成為數字經濟的關鍵支撐。
- 另一方面，我們的陶瓷封裝基座精準匹配晶振的高密封性、高穩定性封裝要求，其下游產品應用於汽車、智能手機、基站、筆記本電腦等產品。

根據弗若斯特沙利文的資料，隨著汽車、物聯網等終端的持續智能化、網聯化發展，晶振需求不斷增加，拉動陶瓷封裝基座產品需求持續增長。

概 要

我們的通信器件已形成顯著競爭力。

- 根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年的收入計，陶瓷插芯及套筒佔據70%以上的全球市場份額；
- 根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年的收入計，在晶振封裝領域，我們的陶瓷封裝基座佔據約40%的全球市場份額；
- MT插芯及短纖、光通信陶瓷封裝管殼等產品也逐步切入高速光模組與高端光器件供應鏈。

設備組件

我們的設備組件產品矩陣包括壓電式微點膠系統、泛半導體陶瓷組件、壓縮機接線端子、陶瓷劈刀、SOFC電堆等。基於在材料配方、材料成型等核心技術上的積累，我們提供的產品不但滿足國產化與能源轉型需求，亦支撐工業領域穩定需求。

我們的設備組件產品應用於半導體製造及封裝、新能源、智能工業控制等多個領域，其中：

- 壓縮機接線端子以優異的密封性能與介電強度，保障空調、冰箱、汽車等壓縮機的運行；
- 陶瓷劈刀為半導體封裝線焊機的焊接工具；
- SOFC電堆基於我們在SOFC領域累積的專業知識延伸，適配分佈式發電場景；
- 泛半導體陶瓷組件滿足先進製造的高純度、高精度需求；及
- 壓電式微點膠系統適配工業自動化與機器人領域的精密點膠需求。

概 要

其他產品

除核心產品外，我們利用在材料及工藝端的積累將產品開發延伸至更多應用領域，主要包括陶瓷外觀件和生物陶瓷等。這些延伸產品與我們的核心產品矩陣形成互補，並拓寬了市場機遇。

我們的增長機遇

我們業務營運所在的行業及市場，其需求增長由技術迭代及應用升級所推動，這使得高端化被動元件的需求持續攀升。根據弗若斯特沙利文的資料，核心先進電子陶瓷材料、核心陶瓷電子元件、核心陶瓷通信器件及核心陶瓷設備組件的全球市場規模預計將分別以11.8%、7.1%、8.3%及11.8%的年複合增長率增長，於2030年分別達到人民幣422億元、人民幣2,517億元、人民幣704億元及人民幣965億元。我們相信，我們的業務的關鍵增長驅動因素包括：

- **下游領域的需求及場景升級**。通信、AI及數據中心、消費及汽車電子、半導體、新能源及智能工業控制同步升級，驅動更高需求量與更嚴格的性能要求，支持行業持續多年增長。
- **更高材料性能要求與功能一體化**。高端場景需要具備更高的熱導率、介電穩定性、純度及在極端條件下的可靠性。陶瓷逐步整合散熱、結構強度及電氣性能等多項功能，為產品微型化、緊湊化設計提供核心支撐。
- **底層研發與跨域創新**。透過產學合作，基礎材料科學結合半導體、新能源及醫療保健領域的技術訣竅，加快實驗室成果轉化至量產，突破性能瓶頸，並開拓全新應用場景。

概 要

- **國產替代與全球 — 本地營運模式**。政策支持與強勁的本地需求，加快材料、元件及設備的國產替代，擴大本地市場參與者的市佔率。憑藉國內產業集群、海外生產基地及本地化技術服務團隊支撐的全球網絡，搭配定製化區域適配策略，可全面提升合規運營效能、優化成本結構、縮短交付週期，並降低貿易與政策層面的潛在風險。

我們的管理和企業文化

在先進電子陶瓷領域深耕半個多世紀的歷程中，我們逐步沉澱出一套與我們以材料為核心的業務模式高度契合的管理與企業文化，既以核心價值錨定發展方向，又通過制度化保障落地效能。

經營層面，我們始終以嚴謹務實的態度堅守主業，依託數字化系統打通全流程運營環節，以標準化支撐效率提升；同時以成果為導向搭建考核與激勵體系，既關注業務目標的穩步達成，也重視跨團隊協同能力建設，更通過專項機制激發研發創新活力，讓技術突破與人才成長形成正向循環。

文化上，我們既強調對專業的尊重與對品質的堅守，以開放姿態推動技術與資源的協同共享與複用，也注重為員工搭建職業發展通道，在支持個人成長的過程中凝聚團隊合力。

這些都指向「為客戶需求提供解決方案、為員工成長搭建發展平台、為股東投資創造增值回報、為社會發展奉獻企業價值」的長期追求，讓穩健發展與卓越追求融入日常運營，支撐我們在行業週期與市場變化中持續前行。

概 要

我們重視回饋股東及投資人對我們的長期支持。自於2014年12月我們的A股於深圳證券交易所創業板掛牌上市以來，我們保持了較高的分紅比例，截至2025年9月30日，自A股上市以來，累計分紅達人民幣4,803.5百萬元。於2022年、2023年及2024年，我們的分紅支付比例(按相關年度已宣派現金分紅除以歸母淨利潤計算)分別為31.8%、33.9%及33.2%。與此同時，我們根據市場動態推出股份回購方案，以進一步提升股東回報。我們於2025年4月首次實施股份回購計劃，截至2025年10月31日我們投入回購股份的總金額達到人民幣175.4百萬元。

財務表現

自2014年於深圳證券交易所創業板完成A股掛牌上市以來，我們實現了穩健的收入增長與優質的盈利水準。於2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們的收入分別為人民幣5,088.7百萬元、人民幣5,681.5百萬元、人民幣7,266.1百萬元和人民幣6,420.5百萬元，同年／同期毛利潤分別為人民幣2,099.9百萬元、人民幣2,154.1百萬元、人民幣2,975.3百萬元和人民幣2,577.5百萬元，淨利潤分別為人民幣1,506.1百萬元、人民幣1,583.2百萬元、人民幣2,190.2百萬元和人民幣1,957.9百萬元，同年／同期經營活動產生的現金淨額分別為人民幣2,073.9百萬元、人民幣1,719.0百萬元、人民幣2,403.1百萬元和人民幣1,990.5百萬元，彰顯長期可持續的價值創造能力。

研發

在技術迭代加速、可靠性標準趨嚴、降本需求持續的市場環境下，我們的研發工作面臨更高挑戰與要求。依託多年技術沉澱與大規模量產實踐經驗，我們構建了「量產一代、儲備一代、研發一代、調研一代」的階梯式四代研發體系，以系統化佈局應對市場和行業需求的快速變化。

概 要

銷售及營銷

截至2025年9月30日，我們的銷售團隊由193名專職銷售人員組成，並已在8個國家和地區完成人員派駐與團隊搭建。我們的產品通過直銷及經銷銷售，其中，MLCC、壓電式微點膠系統及氧化鋁陶瓷基板通過直銷及經銷銷售，而其他類型產品則售予直銷客戶。

客戶及供應商

我們的客戶

我們向新能源設備、電子元件及消費電子設備製造商銷售產品。於往績記錄期間，我們的產品在中國和北美、亞洲、歐洲及全球其他地區銷售。

於2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們向五大客戶的銷售額分別為人民幣784.7百萬元、人民幣1,005.1百萬元、人民幣1,016.9百萬元及人民幣897.5百萬元，分別佔各年度／期間總收入的15.5%、17.6%、14.0%及13.9%。於2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們向最大客戶的銷售額分別為人民幣314.2百萬元、人民幣449.3百萬元、人民幣323.9百萬元及人民幣228.3百萬元，分別佔各年度／期間總收入的6.2%、7.9%、4.5%及3.6%。

據董事所深知，於往績記錄期間，概無董事、其聯繫人或任何股東(據董事所知擁有我們的股本5%以上者)於往績記錄期間任何期間內於我們五大客戶中擁有須根據香港上市規則披露的權益。

我們的供應商

我們已建立全面的供應商選擇及資格審核體系，確保供應鏈的穩定性及可靠性。

於2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們向五大供應商採購金額分別為人民幣482.2百萬元、人民幣505.8百萬元、人民幣829.7百萬元及人民幣711.9百萬元，分別佔各年度／期間採購總額的24.5%、22.1%、26.0%及26.9%。於2022

概 要

年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們向最大供應商採購金額分別為人民幣134.0百萬元、人民幣130.0百萬元、人民幣242.2百萬元及人民幣199.7百萬元，分別佔各年度／期間採購總額的6.8%、5.7%、7.6%及7.5%。

據董事所深知，於往績記錄期間，概無董事、其聯繫人或任何股東（據董事所知擁有我們的股本5%以上者）於往績記錄期間任何期間內於我們五大供應商中擁有須根據上市規則披露的權益。

優勢

我們認為以下優勢有助於我們把握未來行業機遇，實現持續增長：

- 先進電子陶瓷材料和零部件行業領先，多款核心產品的全球市場份額名列前茅
- 一體化業務模式與大規模量產能力共同締造供應鏈自主性、效率及韌性
- 品牌認知積澱與客戶深耕共同鑄造行業信譽與長期合作的基礎
- 全球化網絡縱深佈局，兼顧成本管理與市場拓展
- 深厚技術沉澱構建全鏈條創新護城河，將材料基礎與商業化閉環連接
- 全場景產品矩陣協同發展，鞏固先進陶瓷材料多領域覆蓋優勢
- 深耕行業的穩定管理團隊及融合傳承與創新的治理體系

概 要

戰略

我們將實施以下戰略，推動業務進一步增長：

- 深化核心業務滲透，鞏固全球領先地位
- 延伸垂直產業鏈佈局，強化全鏈條協同能力
- 加強全球品牌建設與生態運營，提升客戶品牌認知與合作夥伴忠誠度
- 升級全球化運營體系，拓展高端市場增量空間
- 聚焦前沿技術研發，構建跨領域創新能力
- 推進智能製造升級，提升生產運營韌性

競爭

我們主要在競爭激烈的電子陶瓷材料及元件行業營運。若我們無法跟上此類技術發展步伐，或未能在產品質量或成本方面建立差異化優勢，我們將面臨市場份額被競爭對手侵蝕的風險。有關競爭格局的詳情，請見「行業概覽」。

歷史財務資料概要

本集團財務資料概要

下表載列了我們於往績記錄期間的合併財務資料中的財務數據概要。下文所載財務數據概要應與本文件附錄一會計師報告所載的合併財務報表（包括相關附註）一併閱讀，並以其為準。我們的合併財務資料乃根據國際財務報告準則會計準則編製。

概 要

經營業績

	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	(人民幣千元，百分比除外)									
	(未經審計)									
收入	5,088,727	100.0%	5,681,529	100.0%	7,266,133	100.0%	5,320,861	100.0%	6,420,540	100.0%
營業成本	(2,988,858)	(58.7)%	(3,527,422)	(62.1)%	(4,290,871)	(59.1)%	(3,147,061)	(59.1)%	(3,843,087)	(59.9)%
毛利	2,099,869	41.3%	2,154,107	37.9%	2,975,262	40.9%	2,173,800	40.9%	2,577,453	40.1%
其他收益、利得和損失										
淨額	566,294	11.1%	699,255	12.3%	673,802	9.3%	425,372	8.0%	532,723	8.3%
銷售及分銷費用	(57,309)	(1.1)%	(74,343)	(1.3)%	(79,392)	(1.1)%	(50,989)	(1.0)%	(66,958)	(1.0)%
管理費用	(485,102)	(9.5)%	(435,487)	(7.7)%	(427,223)	(5.9)%	(274,623)	(5.2)%	(317,028)	(4.9)%
研發費用	(452,172)	(8.9)%	(545,806)	(9.6)%	(583,072)	(8.0)%	(401,234)	(7.5)%	(440,956)	(6.9)%
金融資產減值損失撥回										
(減值損失)淨額	3,637	0.1%	7,610	0.1%	(12,734)	(0.2)%	(8,051)	(0.2)%	(8,023)	(0.1)%
財務費用	(8,899)	(0.2)%	(22,488)	(0.4)%	(27,700)	(0.4)%	(22,635)	(0.4)%	(15,384)	(0.2)%
稅前利潤	1,666,318	32.7%	1,782,848	31.4%	2,518,943	34.7%	1,841,640	34.6%	2,261,827	35.2%
所得稅費用	(160,215)	(3.1)%	(199,697)	(3.5)%	(328,710)	(4.5)%	(237,929)	(4.5)%	(303,888)	(4.7)%
年/期內利潤	<u>1,506,103</u>	<u>29.6%</u>	<u>1,583,151</u>	<u>27.9%</u>	<u>2,190,233</u>	<u>30.1%</u>	<u>1,603,711</u>	<u>30.1%</u>	<u>1,957,939</u>	<u>30.5%</u>

概 要

收入

於往績記錄期間，我們主要從銷售(i)電子及陶瓷材料，(ii)電子元件，(iii)通信器件，(iv)設備組件，及(v)其他產品產生收入。

	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	(人民幣千元，百分比除外)									
	(未經審計)									
電子及陶瓷材料	1,248,886	24.5%	1,548,700	27.3%	1,677,233	23.1%	1,251,065	23.5%	1,382,024	21.5%
電子元件	822,208	16.2%	1,572,349	27.7%	2,298,159	31.6%	1,674,912	31.5%	2,318,637	36.1%
通信器件	2,145,855	42.2%	1,766,754	31.1%	2,305,985	31.7%	1,709,054	32.1%	1,927,257	30.0%
設備組件	437,138	8.6%	477,990	8.4%	536,825	7.4%	406,760	7.6%	458,267	7.1%
其他產品	434,640	8.5%	315,736	5.5%	447,931	6.2%	279,070	5.3%	334,355	5.3%
總計	<u>5,088,727</u>	<u>100.0%</u>	<u>5,681,529</u>	<u>100.0%</u>	<u>7,266,133</u>	<u>100.0%</u>	<u>5,320,861</u>	<u>100.0%</u>	<u>6,420,540</u>	<u>100.0%</u>

下表載列我們的產品於所示年度／期間的銷量及平均售價。

	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價
	人民幣／		人民幣／		人民幣／		人民幣／		人民幣／	
千單位 ⁽¹⁾	單位 ⁽¹⁾	千單位 ⁽¹⁾	單位 ⁽¹⁾	千單位 ⁽¹⁾	單位 ⁽¹⁾	千單位 ⁽¹⁾	單位 ⁽¹⁾	千單位 ⁽¹⁾	單位 ⁽¹⁾	
電子及陶瓷材料	2,832	440.9	2,631	588.7	2,444	686.4	1,910	654.9	1,721	803.3
電子元件	11,541	71.2	24,505	64.2	33,703	68.2	24,251	69.1	34,567	67.1
通信器件	1,547	1,386.9	1,574	1,122.3	1,966	1,172.7	1,486	1,150.3	1,651	1,167.5
設備組件	9	49,588.3	8	56,711.5	9	62,249.1	6	64,294.5	6	75,461.9

附註：

(1) 一單位指一萬件或一千克。

概 要

毛利及毛利率

	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率 ⁽¹⁾	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	(人民幣千元，百分比除外)									
	(未經審計)									
電子及陶瓷材料	611,552	49.0%	662,178	42.8%	661,649	39.4%	484,348	38.7%	520,111	37.6%
電子元件	246,113	29.9%	437,871	27.8%	1,000,328	43.5%	701,367	41.9%	942,998	40.7%
通信器件	895,858	41.7%	702,715	39.8%	977,356	42.4%	699,313	40.9%	818,457	42.5%
設備組件	255,672	58.5%	284,975	59.6%	319,317	59.5%	246,555	60.6%	278,296	60.7%
其他產品	90,674	20.9%	66,368	21.0%	16,612	3.7%	42,217	15.1%	17,591	5.3%
總計/整體⁽¹⁾	<u>2,099,869</u>	41.3%	<u>2,154,107</u>	37.9%	<u>2,975,262</u>	40.9%	<u>2,173,800</u>	40.9%	<u>2,577,453</u>	40.1%

附註：

(1) 毛利率按毛利除以收入再乘以100%計算。

請參閱「財務資料 — 各期間經營業績比較」。

合併財務狀況表概要

	截至12月31日			截至9月30日
	2022年	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			
非流動資產	6,772,591	10,547,584	10,313,768	11,461,392
流動資產	12,820,785	11,279,380	13,602,036	13,919,438
流動負債	1,631,986	2,527,745	2,744,802	3,096,184
流動資產淨值	11,188,799	8,751,635	10,857,234	10,823,254
總資產減流動負債	17,961,390	19,299,219	21,171,002	22,284,646
非流動負債	857,978	1,060,119	1,299,234	1,278,556
資產淨值	17,103,412	18,239,100	19,871,768	21,006,090
權益總額	17,103,412	18,239,100	19,871,768	21,006,090

請參閱「財務資料 — 選定的資產負債表項目」。

概 要

現金流量

下表載列我們於所示年度／期間的現金流量。

	截至12月31日止年度			截至9月30日 止九個月
	2022年	2023年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			(未經審計)
經營活動產生的現金淨額	2,073,874	1,718,968	2,403,122	1,990,456
投資活動(使用)／產生的現金淨 額	(3,806,727)	(3,774,925)	(1,353,931)	2,040,835
籌資活動產生／(使用)的 現金淨額	(628,927)	153,936	(1,205,527)	(878,519)
現金及現金等價物(減少)／增加 淨額	(2,361,780)	(1,902,021)	(156,336)	3,152,772
年／期初現金及現金等價物 . . .	5,543,423	3,191,642	1,297,057	1,140,258
匯率變動的影響	9,999	7,436	(463)	5,653
年／期末現金及現金等價物 . . .	<u>3,191,642</u>	<u>1,297,057</u>	<u>1,140,258</u>	<u>4,298,683</u>

請參閱「財務資料 — 現金流量」。

主要財務比率

下表載列我們於所示年度／期間的主要財務比率。

	截至12月31日止年度／截至12月31日			截至9月30日 止九個月／ 截至9月30日
	2022年	2023年	2024年	2025年
	(未經審計)			
毛利率 ⁽¹⁾	41.3%	37.9%	40.9%	40.1%
淨利潤率 ⁽²⁾	29.6%	27.9%	30.1%	30.5%
權益回報率 ⁽³⁾	8.8%	8.7%	11.0%	9.3%
資產負債比率 ⁽⁴⁾	1.1%	4.2%	2.5%	2.8%

概 要

附註：

- (1) 毛利率乃按相關年度／期間的毛利除以相應年度／期間收入再乘以100%計算。
- (2) 淨利潤率乃按相關年度／期間的利潤除以相應年度／期間收入再乘以100%計算。
- (3) 權益回報率乃按年度／期間的利潤除以相應年末／期末的權益總額結餘再乘以100%計算。
- (4) 資產負債比率按借款及租賃負債除以年末／期末的權益總額結餘再乘以100%計算。

[編纂]

[編纂]指就**[編纂]**及**[編纂]**產生的專業費用、**[編纂]**及費用。我們的**[編纂]**估計約為**[編纂]**百萬港元(包括**[編纂]**)，佔**[編纂]****[編纂]**總額的**[編纂]**%(假設**[編纂]**為每股股份**[編纂]**港元(即本文件所述**[編纂]**範圍的中位數))。**[編纂]**中，約**[編纂]**百萬港元直接與**[編纂]**股份有關，並將於**[編纂]**完成後自權益扣除，而約**[編纂]**百萬港元已或將會自合併綜合收益表扣除。於往績記錄期間產生及預期產生的**[編纂]**包括**[編纂]**相關開支及費用(包括**[編纂]**、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)約**[編纂]**百萬港元、**[編纂]**開支及費用(包括獨家保薦人、法律顧問及申報會計師費用)約**[編纂]**百萬港元以及其他**[編纂]**費用及開支約**[編纂]**百萬港元。於往績記錄期間，我們並無產生**[編纂]**。

上述**[編纂]**為最新實際可行估計金額，僅供參考，實際金額可能與此估計金額不同。

概 要

與控股股東的關係

截至最後實際可行日期，張先生合共控制本公司已發行股本總額約**36.47%**，其中包括(i)直接權益約**2.80%**，及(ii)通過三江投資(張先生持有**59.21%**股權)持有的間接權益約**33.67%**。

緊隨**[編纂]**完成後(假設**[編纂]**未獲行使)，張先生將通過三江投資合共控制本公司已發行股本總額約**[編纂]%**。因此，根據上市規則，張先生及三江投資將於**[編纂]**後共同構成一組控股股東。

詳情請參閱「與控股股東的關係」。

風險因素

我們面臨的風險包括「風險因素」一節所載的風險。由於不同投資者在判斷風險的重要性時可能會有不同的理解及標準，故在決定**[編纂]**我們的**[編纂]**前，閣下應閱讀「風險因素」一節全文。我們面臨的部分主要風險包括：

- 我們的業務面臨先進電子陶瓷材料及元件行業的動態供需的影響，並受使用我們材料及元件的終端產品的下游需求所影響。
- 若我們無法留住現有客戶及吸引新客戶，則我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。
- 我們的國際策略及在不同司法管轄區開展業務的能力受不確定因素及風險所影響。
- 原材料價格波動可能對我們的盈利能力及財務狀況造成不利影響。
- 我們從外部採購原材料，而我們未必能穩定且及時地獲得該等材料的供應。

概 要

在深圳證券交易所創業板上市

於2014年12月，本公司A股在深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300408.SZ)(「A股上市」)。本公司A股上市發售合共46,000,000股A股，佔緊隨A股上市完成後本公司經擴大股本的10.7%。緊隨A股上市完成後，本公司股本增加至人民幣428,800,000元。

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]範圍的中位數)，我們估計，經扣除與[編纂]有關的[編纂]及其他估計開支後，我們將自[編纂]獲得[編纂]淨額約[編纂]百萬港元(假設[編纂]未獲行使)。我們擬按下列金額將我們的[編纂]用於下列用途。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將投資於國外新建擴建項目以及自動化建設，以提高產能、提高效率及加強供應韌性。主要措施包括以下位於泰國及德國的項目，以滿足客戶需求、縮短交貨時間及加強我們的全球服務網絡。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於技術迭代和材料創新，夯實「材料 — 工藝」一體化技術壁壘，支持全球化業務拓展，並推進關鍵環節的國產替代。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於營運資金及其他一般企業用途，包括日常運營及一般企業支出。

請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

概 要

[編纂]統計數據

下表統計數據乃基於以下假設：(i)[編纂]已完成及[編纂]中新發行[編纂]股H股，(ii)[編纂]未獲行使，及(iii)並無根據股權激勵計劃發行任何額外股份：

	基於[編纂] 每股H股[編纂]港元	基於[編纂] 每股H股[編纂]港元
H股[編纂] ⁽¹⁾	[編纂]百萬港元	[編纂]百萬港元
本公司總[編纂] ⁽²⁾	[編纂]百萬港元	[編纂]百萬港元
未經審計[編纂]經調整 每股有形資產淨值 ⁽³⁾⁽⁴⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) H股市值基於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)預期將發行的[編纂]股H股計算得出。
- (2) 本公司[編纂]基於截至最後實際可行日期已發行1,916,497,371股A股及緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)預期將發行的[編纂]股H股計算得出。A股市值基於緊接最後實際可行日期前五個營業日期間的平均收市價每股A股[編纂]計算得出。
- (3) 未經審計[編纂]經調整每股有形資產淨值經「附錄二A — 未經審計[編纂]財務資料」一節所述調整後得出。
- (4) 未經審計備考經調整每股有形資產淨值並無作出調整，以反映於2025年9月30日後我們的任何交易業績或訂立的其他交易。

[編纂]

概 要

股利政策

在《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號 — 上市公司現金分紅(2025年修訂)》等中國法律法規以及公司章程的規限下，綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，進行利潤分配時，我們須派付不少於本次利潤分派中可供分派利潤**20.0%**的現金股利。此外，我們進行利潤分配時優先考慮現金股利政策。若我們在某一財政年度實錄得利潤，在根據適用法律法規彌補虧損、提取法定盈餘公積金及任意公積金後，剩餘可供分派利潤應以現金股利的形式進行分配。利潤分配不得超過累計可供分派利潤總額。在無重大投資計劃或重大資本開支安排的情況下，我們分配的現金股利應不低於該年度實現的可供分派利潤的**30.0%**。

有關我們於往績記錄期間宣派的股利，請參閱「附錄一 — 會計師報告」附註**13**。

未來利潤分派可以採取現金股利或股票股利或兩者相結合的方式進行。任何建議的股利分派均須經董事會酌情決定並經股東大會批准。董事會經考慮我們的經營業績、財務狀況、經營要求、資本要求、股東利益以及董事會認為相關的任何其他條件後，可能會建議在未來分派股利。

無重大不利變動及近期發展

董事確認，截至本文件日期，我們的財務狀況自**2025年9月30日**起並無重大不利變動，而自**2025年9月30日**以來亦無發生任何會對本文件附錄一會計師報告所載資料構成重大影響的事件。